

企业研究报告

中科寒武纪

2019年





寒武纪是中科院计算所下孵化的AI芯片研发单位，团队曾参与研发国产“龙芯”芯片，在AI芯片领域发表了多篇领先业界的芯片架构及指令集设计论文，多篇论文获取学界顶级奖项，技术储备雄厚。



公司自2016年成立以来已进行多轮融资，当前估值已达到25亿美元。公司股东除实际控制人及中科院外还有多家带有国资背景的基金，以及以阿里、科大讯飞、联想等为代表的上市公司。



公司自16年成立已经推出了面向终端市场的1A/1H/1M产品及针对云数据中心训练端的MLU100产品，并且开发了针对于NN运算的通用ISA和针对于自家芯片的SDK。1A和1H产品已经被华为麒麟系列芯片SoC所采纳，此外，公司与多家服务器厂商推出针对云端推理场景的智能服务器产品。



目前已有大量科技公司及人才涌入智能芯片领域，其中除近几年成立的大量创业公司外，传统的芯片、科技巨头也在布局该领域。在面对行业竞争及挑战时，相比起终端市场，公司在云计算领域有更强的产品（硬件+软件）及产业竞争优势



推测公司未来有望成为首批科创板挂牌企业，通过上市实现二级市场融资以支持公司进一步发展资金需求。

公司基本情况介绍	1
AI芯片简介	2
公司业务&竞争力分析	3
总结	4

公司基本情况介绍

公司是中国人工智能芯片领域独角兽企业

寒武纪是全球智能芯片领域的先行者，是全球第一个成功流片并拥有成熟产品的智能芯片公司。公司的使命是打造各类智能云服务器、智能终端以及智能机器人的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。

公司在2016年推出的寒武纪1A处理器是世界首款商用深度学习专用处理器，已应用于数千万智能手机中，入选了第三届世界互联网大会评选的十五项“世界互联网领先科技成果”。公司在2018年推出的MLU100机器学习处理器芯片，运行主流智能算法时性能功耗比全面超越CPU和GPU。目前，寒武纪已与智能产业的各大上下游企业建立了良好的合作关系。

公司工商信息概览

项目	内容
公司名称	北京中科寒武纪科技有限公司
成立时间	2016年3月
注册资本	137.65582万元
主营业务	人工智能AI芯片的研发、生产和销售

来源：天眼查；国家企业信用信息公示系统。

公司核心团队介绍

团队成员有深厚的中科院计算机所背景，曾参与中国首款通用MIPS架构CPU“龙芯”的研发和设计工作。

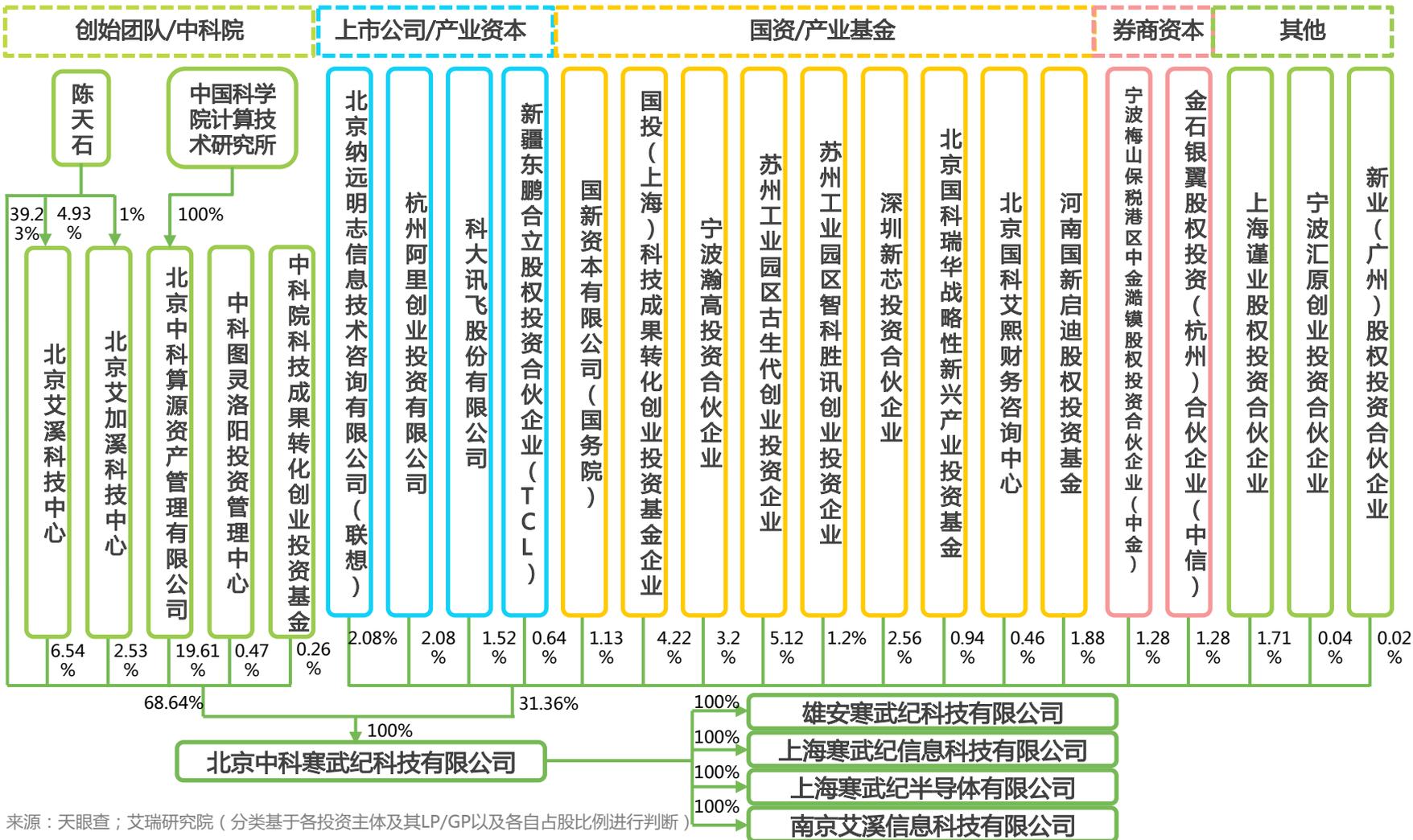
公司核心团队人员背景介绍

创始人	公司职务	个人履历
陈天石	公司创始人、CEO	2005年毕业于中国科学技术大学少年班获得理学学士学位。2010年获得中国科学技术大学计算机学院工学博士学位，历任中国科学院计算技术研究所助理研究员、副研究员、研究员（正教授）和博士生导师 在处理器架构深耕十余年，曾获得国家自然科学基金委员会“优青”、中国计算机学会科学技术一等奖、CCF-Intel青年学者奖、中国计算机学会优秀博士学位论文奖
刘少礼博士	公司副总裁	2009年获得南开大学数学学院学士学位，2014年获得中国科学院计算机研究所博士学位，历任中国科学院计算机研究所助理研究员、副研究员（副教授）和硕士生导师。 2016年3月加盟寒武纪，具有8年的芯片研发经验，参与“龙芯”的结构设计，担任世界首个深度学习处理器芯片的主架构师
刘道福博士	公司副总裁	2010年获得中国科学技术大学计算机学院学士学位，2015年获得中国科学院计算技术研究所博士学位，历任中国科学院计算技术研究所助理研究员、高级工程师 2016年加盟寒武纪科技，具有8年芯片研发经验，有负责多款芯片流片的经验。
王在博士	公司副总裁	2006年获得中国科学技术大学计算机学院学士学位，2017年获得中国科学技术大学博士学位，研究方向为人工智能。 2011年至2015年曾任郑州商品交易所任核心交易系统开发工程师，2015年至2016年任中原银行渠道组负责人管理电子银行、手机银行、微信银行及呼叫中心等众多项目，2016年3月加盟寒武纪。
陈云霄	首席科学家	中国科学院计算技术研究所研究员、博士生导师，担任中国科学院脑科学卓越中心特聘研究员、中国科学院大学教授，师从龙芯首席科学家胡伟武，曾任龙芯3号总设计师。曾获得2014年“CCF青年科学家奖”、首届国家自然科学基金“优秀青年基金”、首届国家万人计划“青年拔尖人才”、中国计算机学会青年科学家奖以及中科院青年人才奖，其所带领的科研团队获得全国“青年文明号”和中央国家机关“青年文明号”的称号 曾在国际顶级学术会议及期刊上发表论文60余篇，目前带领实验室研制寒武纪深度学习处理器。

来源：寒武纪官网；网络公开数据。

公司股权结构

公司是“中科系”背景芯片研发国家队



公司发展历史

公司团队有十年的发展史并积攒了丰富的技术储备

公司工商主体虽然成立于2016年，但实际初创团队从2008年即开始了相关技术的研发工作，并先后在世界顶级学术会议上发表了多篇AI芯片硬件架构及指令集论文，其中多篇论文入选了当年的顶级论文。公司自16年成立以来，快速实现了技术的产业化输出，先后推出了用于终端场景的1A/1H/1M系列芯片及云端场景的MLU100芯片及计算卡产品，其中1A/1H应用于华为麒麟系列芯片，MLU系列产品应用于多家云服务器厂商产品，获得了不错的市场反馈。公司自成立以来，已经获得了3轮股权投资，总共融资金额达到了数亿美元，为公司持续研发备足了充分的“弹药”。

公司发展历史概览



来源：寒武纪官网；网络公开数据。

公司基本情况介绍	1
AI芯片简介	2
公司业务&竞争力分析	3
总结	4

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21151

